

『第18回 半導体パッケージング技術展』出展のご案内
(総称 ネブコン ジャパン 2017)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社は、2017年1月18日(水)～20日(金)に開催されます『半導体パッケージング技術展』に、内藤電誠グループとして出展致します。ご多用とは存じますが、展示会招待券にてご来場いただき、弊社の製品・技術・サービスをご高閲賜りたく、ご案内申し上げます。

※招待券は、弊社担当者宛へご連絡いただくか、[展示会公式HP](#)でもご登録いただけます。

貴社への詳細な技術打合せ等に対応出来るスタッフを準備いたしますので、事前にご来場日時をF a x。または、[アポイント申込み](#)にてご連絡いただけますと幸いです。

敬具

会 期 : 2017年1月18日(水) ~ 20日(金)
会 場 : 東京ビッグサイト 西展示棟 1階 1ホール
ブース番号 : W1-62

【出展製品・サービス 一例】

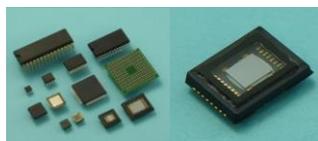
●IC生産ターンキーソリューション



大手半導体メーカーが対応しない少量生産のカスタムIC開発を、設計から生産まで、国内自社リソースで対応いたします。

- ・少量生産のカスタムIC開発に対応
- ・設計から生産まで、国内自社リソースで対応
- ・自社所有設備による信頼性試験対応

●半導体パッケージング サービス



試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

- ・QFN、QFP、SOP系、DIP系、BGA などのパッケージング
- ・光学センサやMEMSセンサなどに適した各種プラスチック中空パッケージ技術
- ・特殊パッケージや試作工事などのカスタム対応

●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・調査解析の受託サービスでお客様の品質向上をサポートいたします。

- ・信頼性評価・環境試験
各種環境試験、連続モニタ、リフロー耐熱性試験、リボール、染色評価、熱抵抗測定
- ・物理解析・断面解析
顕微鏡観察、X線(CT)観察、SAT観察、PKG開封、SEM/EDX、断面加工

他にも多数製品や技術、サービスのご紹介を用意してお待ちしております。

【ブース位置】

■ 東京ビッグサイト 西展示棟 1階 1ホール

IC工房
内藤電誠グループ
W1-62



内藤電誠工業株式会社

デバイスカンパニー 経営本部 営業部

Tel. 044-431-7125 Fax. 044-431-7135

[アポイント申込みはこちらから](#) ←クリック

URL <http://devices.lsi.ndk-grp.co.jp/>

内藤電誠工業(株) 半導体パッケージ技術展担当 行き

Fax. 044-431-7135

■■■ アポイント連絡票 ■■■

ご都合の良いお時間を Fax.または E-Mail にてご連絡お願いいたします。

ご指定の日時に担当者が弊社ブース（受付）にてお待ちしております。

ご来場予定時間： 1月 日（ ） 時頃

貴社名： _____ ご所属部署： _____

お役職： _____ ご芳名： _____

TEL： _____ FAX： _____ E-Mail： _____

ご商談対象のサービスへ をご記入願います。

- IC生産ターンキーソリューション、アナログ設計
- 半導体パッケージング
- 信頼性評価・調査解析

商談内容やご要望、弊社担当者のご指名などご記入願います。（適任者選定の参考とさせていただきます。）
